

●USP-6EL 許容損失

USP-6EL パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pb フリーはんだ

実装基板: 基板 40mm × 40mm (片面 1600mm²) に対して

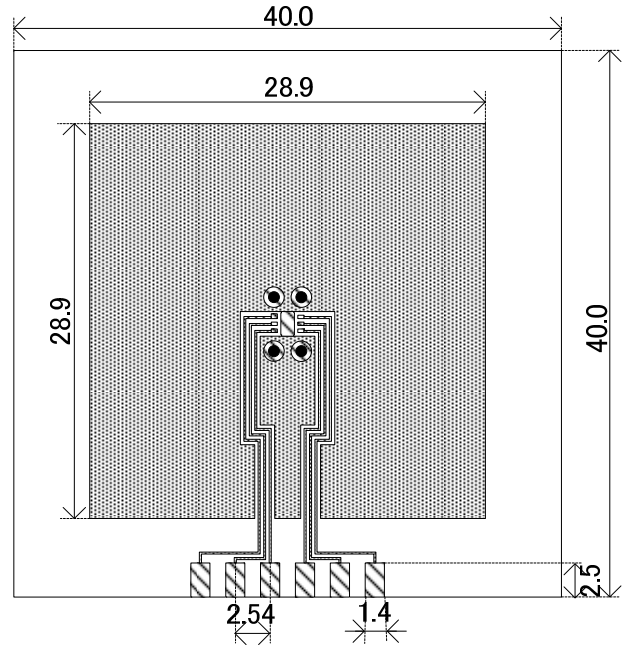
銅箔面積 表面 約 50%-裏面 約 50%

放熱板と周りの銅箔接続

基板材質: ガラスエポキシ (FR-4)

板厚: 1.6mm

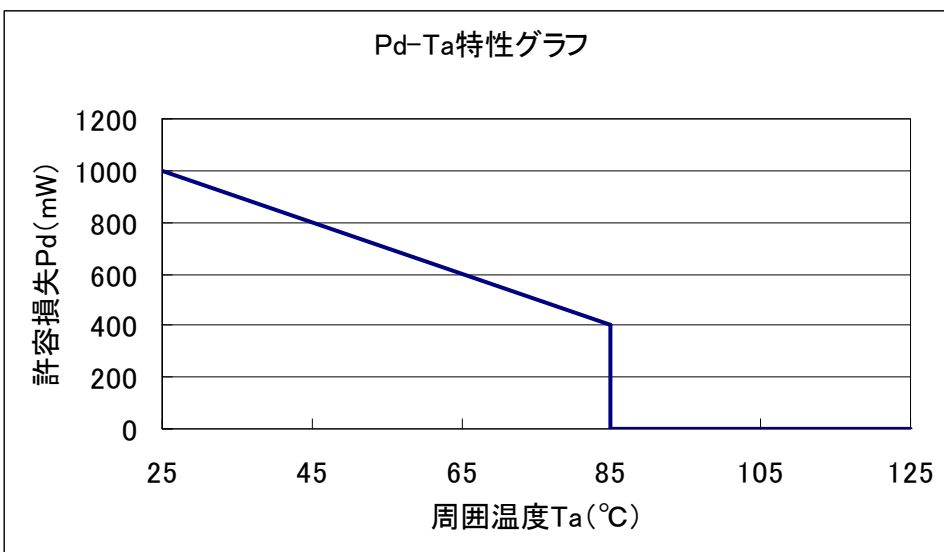
スルーホール: ホール径 0.8mm 4 個



2. 許容損失-周囲温度特性

周囲温度 (°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗 (°C/W)
25	1000	100.00
85	400	

基板実装 (T_{jmax}=125°C)



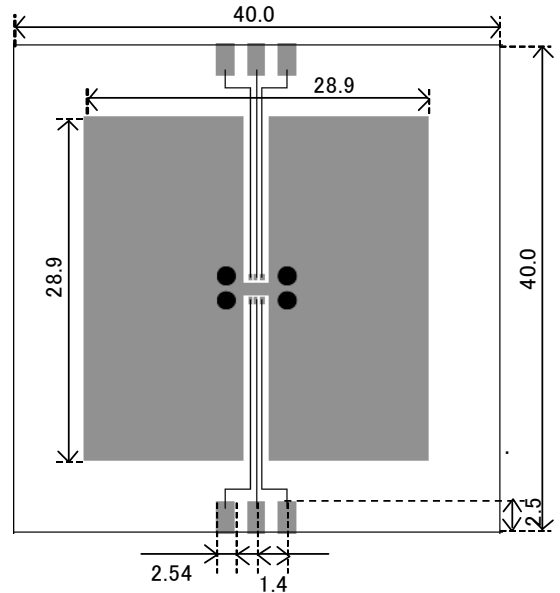
USP-6EL(DAF)パッケージ許容損失

USP-6EL(DAF)パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

- 測定条件: 基板実装状態
- 雰囲気: 自然対流
- 実装: Pbフリーはんだ
- 実装基板: 基板40mm×40mm(片面1600mm²)に対して
銅箔面積 表面 約50%-裏面 約50%
放熱板と周りの銅箔接続
- 基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)
- 板厚: 1.6mm
- スルーホール: ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	熱抵抗(°C/W)
25	750	133.33
85	300	

